

DATENBLATT

Stand: 01. Juni 2018



Kupferfolie 35 my

- HTE Grade 3
- Standard Grade 1
- gem. IPC 4562
- exzellentes Dehnungsvermögen

Einsatzgebiete

- ▶ ideale Oberfläche für Leiterplatten
- ▶ zur Herstellung elektronischer Bauteile, z.B. von Computerbauteilen

Technische Daten

Flächengewicht:	285 g/m ²
Reißdehnung:	> 10%
Reißdehnung bei 188°C:	> 4%
Haftfestigkeit:	> 1,69 N/mm
Rauigkeit Glanz-Seite:	< 0,43 my
Matte-Seite:	5 - 8 my
Zugfestigkeit:	>300 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis + 150°C

Lieferform

Zuschnitte und Stanzteile gemäß Kundenwunsch.
Auch selbstklebend erhältlich z.B. mit elektrisch leitfähigem Klebauftrag

Vorstehende Angaben sind Richtwerte bzw. Laborwerte und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für die Eignung unserer Produkte im Einsatz mit anderen empfehlen wir Vorversuche durchzuführen. Wir gewährleisten gemäß unserer AGB gleichbleibend hohe Produktqualität, können aber wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten keine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse geben. Vorherige Ausgaben dieses Datenblatts verlieren hiermit ihre Gültigkeit.